

製品情報
SOP IC変換基板 SSP-101

※パターン図の縮尺率は一定ではありませんのでご注意ください。

1.0mmピッチMAX.20ピン用

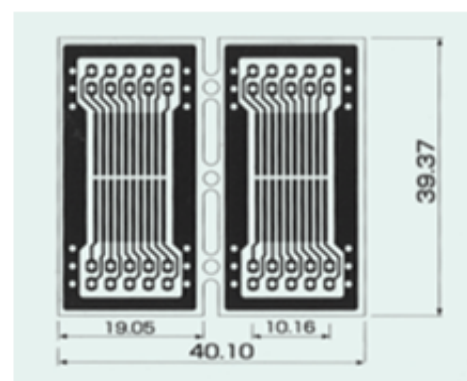
主な仕様

寸法	39.37×40.10mm
材質・板厚	両面・ガラスエポキシ1.0t
仕上処理	スルホール金メッキ レジスト
外周ランド	2.54mmピッチ 穴径0.9φ
表面	2.54mmピッチ面実装用ランド
備考	1.0mmピッチMax.20ピンIC用 2枚続き

ピッチ/mm	最大ピン数
1.0	20



SSPシリーズ
ウラ面パターン


変換基板の使用方法

- 基板の中央ICをハンダ付けし周辺のランドから配線を引き出します。
- ピン数の少ないICはパターン中央部をご使用ください。
- ピン配列等により搭載できないICがありますのでご注意ください。



この製品は、RoHS対応製品です。

「RoHS対応」は電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEU指令(2002/95/EC)及びその修正指令(2005/717/EC)に基づいて判断しています。